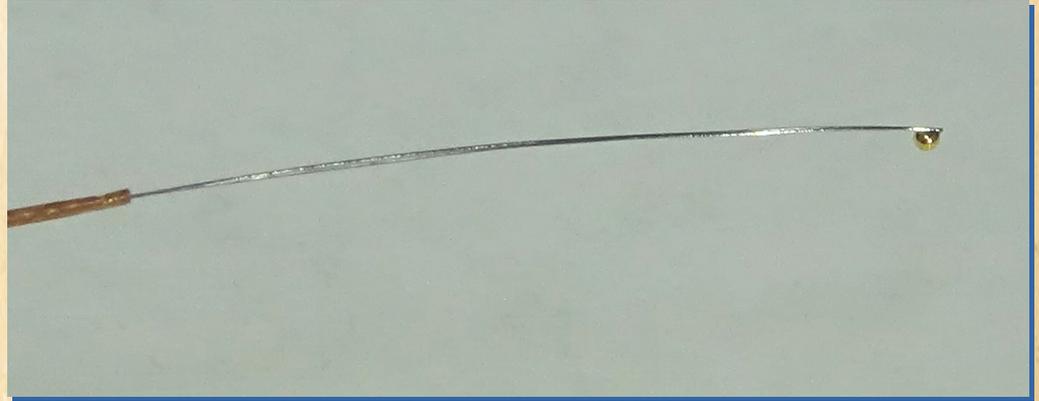


KSP シリーズ

ソフトコンタクトプローブ



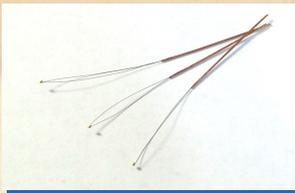
壊れやすい試料表面を壊さずコンタクト



NIMS 特許第 6408257 号実施許諾契約に基づく

KSP コンタクトプローブは、半球形状の Au ボールコンタクト、ワイヤのバネ性によって極めて脆性の高い試料最表面を壊すことなくソフトに接触することが可能です。

既存のプローバーへの装着するためのアタッチメントは複数用意しています。従来の装置に取り付けてお使いいただければ、諦めていた脆性試料（有機薄膜、極薄金属膜、グラフェン膜、MOF 等）の物性測定や高電圧印加といったトライアルが可能になります。



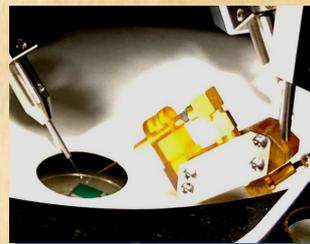
- ・標準タイプ
φ0.5 mm の Cu パイプに挿入されています。



- ・SMA タイプ
同軸接続を要するアタッチメントにも対応いたします。



- ・Au ボール
サンプルにコンタクトする Au ボール
(φ600~700μm 径)



- ・既存プローバーへの装着例（上図）
- ・特注応用機器の開発にも鋭意対応いたします。

合同会社 **KIK**